

2026 年 9 月 10 日

各 位

会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社

代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和

所 在 地 京都府向日市ニデックパーク 33 番地 C 棟

SEMICON INDIA 2026 への出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2026 年 9 月 17 日(木)～9 月 19 日(土)にインド・ニューデリーで開催される、半導体関連イベント「SEMICON INDIA 2026」に出展します。



本展示会は、世界 20 カ国から 500 社以上の企業が集結するインド最大の半導体関連イベントです。本年は「Transform Tomorrow: Silicon to Systems: Building the Ecosystem」をテーマに、半導体関連の素材からシステムまでを網羅した展示が行われます。

当社ブースでは、高度なプロービング技術に応用したプローブカードをはじめ、ウェハ、チップ、基板、パッケージに至るまで、各製造工程で必要な電気検査・外観検査の最新ソリューションをご提案いたします。また、急速に電動化が進む自動車業界に向けて、性能評価および耐久試験の効率化を実現する「TDAS シリーズ（モータ/E-Axle 用テストベンチ）」や、EV の車両設計・解析シミュレーションソフトウェア「E-Transport Simulator®」も併せて展示いたします。

〈出展概要〉

- ・会 期：2026 年 9 月 17 日(木)～9 月 19 日(土)
- ・会 場：Yashobhoomi（インド国際コンベンション&エキスポセンター）
- ・ブ ース：H4305, Hall 2

〈出展内容〉

- STAR REC シリーズ(サーバー、通信、自動車製品、PC、スマートフォン基板検査装置)
- GATS シリーズ(半導体パッケージ向け自動検査装置)
- NATS シリーズ(IGBT/SiC モジュール向け絶縁/静特性/動特性検査装置)
- RWi-300MK3(2D/3D ウェハーバンプ検査装置)
- AURCA シリーズ(3D/AFVI AI 検査システム)

- RSH シリーズ(高密度基板対応 2D/3D 検査装置)
- 高精度検査治具
- TDAS シリーズ(モータ/E-Axle テストベンチ)
- E-Transport Simulator® (xEV モデリングシミュレーター)
- プローブカード (半導体ウェハ検査)